

## Nowy system do wykonywania struktury LPKF LDS dla dużych anten, zaprezentowany na targach Productronica 2011



Kilka setek milionów trójwymiarowych, inteligentnych anten komórkowych zostało dotąd wyprodukowanych przy zastosowaniu technologii LDS. Firma LPKF zamierza rozszerzyć ten zakres dzięki wprowadzeniu nowego, laserowego systemu przeznaczonego do wykonywania struktury anten, których długość może wynosić do nawet 40 cm. Takie rozwiązanie jest idealne dla tabletów oraz laptopów.

Stosowanie procesu LDS powoduje, że komponenty plastikowe są produkowane w jednym cyklu wtryskarki. Podczas naświetlania laserem następuje uwalnianie i aktywacja specjalnych, czynnych substancji (domieszek) w mieszance plastików. W procesie tym, laser powoduje także powstawanie mikroskopijnej wielkości ścieżek. Na skutek zanurzenia czystych, poddanych uprzednio strukturyzacji laserowej komponentów plastikowych w kąpieli, następuje osadzanie się warstw miedzi i w efekcie powstaje gotowy detal elektroniczny, który może zostać natychmiast wykorzystany do wykonywania mechanicznych zadań.



Niedawno wprowadzony na rynek, system LPKF Fusion3D 1500 powiększa zakres rozmiarów anten. W konsekwencji, możliwe będzie teraz produkowanie większych komponentów. Do tej pory, elementy LDS mogły być strukturyzowane jedynie w polu skanowania o wymiarach 120 x 120 x 50 mm, które stanowi rozwiązanie odpowiednie dla anten komórkowych przeznaczonych dla smartfonów. Jednak to już przeszłość. Wraz z wdrożeniem systemu Fusion3D 1500 i jednoczesnym powiększeniem pola skanowania (do wymiarów 160 x 160 x 80 mm), rozmiary komponentów mogą zostać zwiększone o 30%. Natomiast jeśli kilka pól zostanie umieszczonych koło siebie w kolejnych fazach, to wówczas możliwe jest uzyskanie komponentów o jeszcze większych rozmiarach.

„System jest wyposażony w dwa podajniki, dlatego istnieje możliwość wykonywania struktury dla dwóch długich komponentów, których wymiary wynoszą nawet do 400 x 78 x 80 milimetrów, bez marnowania cennego czasu,” tłumaczy Nils Heininger, dyrektor jednostki organizacyjnej Cutting & Structuring Laser. Kolejną, wyróżniającą cechą nowego systemu LPKF Fusion 3D 1500 jest możliwość wyposażenia go w wieloprotocowy kontroler sterujący, który umożliwia jednoczesną pracę nawet trzem źródłom laserów. Skutkuje to znaczącym zredukowaniem czasu trwania całego procesu. Warto podkreślić fakt, że mimo tych wszystkich udoskonaleń, nowy system laserowy wymaga tylko jednego zasilania, wyciągu i może być umieszczony na rolkach, co bardzo ułatwia transport.

Fusion3D 1500 jest już dostępny i stanowi doskonałe uzupełnienie szerokiej oferty produktów firmy LPKF Laser & Electronics AG.

Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.  
ul. Stępińska 22/30 lok. 209 00-739 Warszawa  
tel. 022 840 91 10 fax. 022 841 20 10  
[www.spezial.pl](http://www.spezial.pl)